证券代码：300223　　证券简称：君正股份

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20261110

投资者关系活动类别	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 □其他　（_____）
参与单位名称及人员姓名	中信电子：程子盈、陈瑞阳；博时基金：陈雨薇；南方基金：章晖等
时间	2026 年 11 月 10 日
方式	线上电话交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：张敏
投资者关系活动主要内容介绍	**1、存储中各产品线的占比和增长情况？** 存储中，增长最快的是 DRAM，占比大概 50%多，Flash 占比将近 40%，SRAM 因其他产品线收入提升占比有所下降，不到 10%。SRAM 相对往年来说，收入成长性还是不错的，但是 DRAM 和 Flash 增长要更快些。 **2、对海外客户未来价格涨幅的展望？** 平均涨幅不好确定。从 DRAM 来看，目前需求仍然旺盛，产能依然非常紧张，公司已结合成本及市场情况对大部分客户完成调价，后续部分物料价格仍存在上涨可能，但也要看总体市场情况，预计调价幅度和范围会有所收窄。从 Flash 来看，客户今年持续加大订单，今年的销量同比去年大幅增长，预计明年的成长性会相对更好。全年来看，存储业务收入有望保持较好的水平。 **3、DRAM 在 27 年产能和销量的增速如何？DDR3 和 DDR4、**

	LPDDR4 的占比结构如何？ 27 年产能仍然较为紧张，销量能否增长、增长多少存在不确定性，公司将积极争取产能。根据代工伙伴 28 年的产能规划情况，公司有机会在 28 年争取到更多的产能。 今年 DDR4 和 LPDDR4 占比提升是最明显的，随着公司新制程的 DDR4、LPDDR4 今年开始规模销售，前三季度占比已经超过 DDR3，在 DRAM 产品中保持在 40%以上的收入占比，但由于 DDR4、LPDDR4 产能非常紧张，收入占比的提升一定程度受到产能的限制。如果后续能够获得更多产能，DDR4 和 LPDDR4 占比有望继续提高。 另外，受产能影响公司 3D DRAM 投片进度有所推后；目前我们正在和客户配合开发 Wide I/O DRAM 产品，这个产品投片预计早于 3D DRAM。 **4、存储看成本端变化是怎么样的？后续是否会继续提升？** 在存储产品中，DRAM 成本上涨多一些，不同代工厂涨价幅度存在差异，公司会结合采购量统筹安排。NOR Flash、SRAM 等产品目前成本上涨相对平稳。今年以来，公司产品调价可以完全覆盖成本端上涨，因此毛利率一直在持续提升。明年成本端预计还会有所上涨，公司部分产品预计也可能还有一定调价空间，具体还要看后面的需求情况，包括 AI 会不会继续占用更多的存储产能资源。 **5、存储各产品线的市场拆分占比？** 今年前三季度，整个存储在下游应用中，车规占比 40%多，工业医疗 30%多，通信消费（偏利基市场）20%左右，各领域的收入占比和以前相比变化不大。 **6、NAND 上公司有布局吗？** 在 NAND Flash 方面，因三星、美光已削减该领域产能，叠加终端需求旺盛，导致市场高度紧缺、价格年内涨幅接近十倍；公司已在 SLC、MLC 及小容量 NAND 领域做了大量工作以进行产能储备，相关产能预计将于明年下半年或 28 年陆续释放并投入市场。 **7、请介绍一下近期推出的 Wide I/O DRAM 的情况？**

	从进度上看，预计 Wide I/O DRAM 有望较 3D 堆叠 DRAM 更早实现量产，由于 3D DRAM 需要代工厂的资源较多，目前产能紧张，进度相对较慢。Wide I/O DRAM 主要面向端侧应用，目前已与客户配合开发，容量覆盖 1Gb 到 16Gb，带宽更宽，在手机、穿戴等端侧 AI 领域均可应用。 **8、计算芯片毛利率情况？** 计算芯片主要是消费市场，由于存储原材料缺货涨价，公司计算芯片也相应涨价，前三季度毛利率持续提高，目前看三季度可能是毛利率的高点，后续有可能会开始回落，具体需视市场情况而定。目前公司已开发不带 KGD 的产品，客户可以灵活地安排自己的产品规划。此外，明年 AI-MCU 将开始量产销售，对计算芯片的收入会是一个增量。 **9、目前长协如何签订？** 目前已经在和部分客户商谈明年的协议，由于供应仍然十分紧张，因此公司无法承诺保价保量，具体协议会根据客户需求情况确定，预计价格还是会保留季度调整的权利。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 10 日